

2015エポキシ樹脂・応用製品市場の実態と展望

Market & Prospect of Epoxy Resin and product 2015

S&T出版 検索

| | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| 2014年11月28日発行 | A4判 並製 262頁 | 価格 |
| ISBN978-4-904482-13-1 | | 本体 75,000円+税 ≪割引特典対象外、キャンセル不可≫ |

発行

(株)シーエムシー・リサーチ

エポキシ樹脂は1930年代に開発されて以降、あらゆる分野で実績を積みながら発展が続いている。接着性や、電気特性、強度、耐溶剤性といった特性を活かし、塗料や接着剤、電気・電子部品、建設関連で使用されてきた。

経済産業省生産動態統計によると、国内の生産量は2011年が162,432トン、2012年は149,995トン、2013年は136,797トンと国内生産量は減少の一途をたどっている。国内需要の低下や工場閉鎖などにより生産量の減少に拍車がかかっている一方で、世界におけるエポキシ樹脂の需要を見ると今後年々増加が見込まれている。その需要の約半分を占めるとともに、世界最大の生産国にもなっているのが中国である。大規模な生産設備を有し、汎用タイプのエポキシ樹脂はその安さから中国製品が世界を席巻している。その一方で、高付加価値タイプのエポキシ樹脂についてはまだ途上にある。高付加価値タイプの生産能力を増強し始めているものの、技術面でもまだその需要を満たしてはいない。日本のエポキシ樹脂ユーザーは汎用タイプのエポキシ樹脂を輸入に切り替え、高付加価値製品を日本で調達する動きを見せている。今後、日本のエポキシ樹脂メーカーはこれまでのエポキシ樹脂の製造技術を活かし、高付加価値タイプのエポキシ樹脂に切り替えるといった動きが活発になるであろう。

本書は、以上のようなエポキシ樹脂業界全体の現状をまとめ、分析したものである。第I編ではエポキシ樹脂並びに樹脂原料、主要フォーミュレーターの動向についてまとめ、第II編ではエポキシ樹脂を用いた製品市場についてまとめている。海外の動向を示すため、第III編では中国の市場を、第IV編では世界の市場についてまとめた。

本レポートが今後のエポキシ樹脂関連業界の発展に寄与できることを願い、関係企業の事業戦略立案などにおいて参考になれば幸いである。

I 原料編

- 1 エポキシ樹脂の市場規模
 - 1.1 市場展開 1.2 市場動向 1.3 需要予測
- 2 エポキシ樹脂の分類
 - 2.1 エポキシ樹脂の品種別化学構造 2.2 エポキシ樹脂硬化剤
- 3 主要エポキシ樹脂メーカーの展開
- 4 エポキシ樹脂業界の再編
- 5 生産能力
 - 5.1 国内のエポキシ樹脂メーカーの生産能力 5.2 世界のエポキシ樹脂メーカーの生産能力
- 6 エポキシ樹脂メーカーと製品
- 7 エポキシ樹脂用原料
 - 7.1 ビスフェノールA 7.2 エピクロロヒドリン 7.3 ビスフェノールF
- 8 主要フォーミュレーターの概要

- 16.3 LED封止材参入メーカー 16.4 LEDパッケージ
- 16.5 LEDの市場規模 16.6 主なLEDパッケージメーカーと製品
- 17 アンダーフィル材
 - 17.1 アンダーフィル材の概要 17.2 アンダーフィル材の市場規模
 - 17.3 アンダーフィル材メーカーと製品
- 18 ダイボンドペースト・フィルム
 - 18.1 ダイボンドペースト・フィルムの概要 18.2 ダイボンドペースト・フィルムの市場規模
 - 18.3 ダイボンドペースト材料メーカーと製品
- 19 導電性材料
 - 19.1 導電性材料の種類と要求特性 19.2 導電性材料の市場規模
 - 19.3 導電性ペーストの接着剤・塗料メーカーと製品
- 110 UV硬化性樹脂
 - 110.1 UV硬化性樹脂の市場動向 110.2 エポキシアクリレートオリゴマー
 - 110.3 UV硬化型樹脂の特長 110.4 UV硬化樹脂の市場規模
 - 110.5 UV・EB硬化用オリゴマー参入企業 110.6 UV硬化材料メーカーと製品
 - 110.7 UVインキメーカー
 - 11.1 その他電子部品の動向
 - 11.1.1 抵抗器 11.1.2 コンデンサ 11.1.3 変圧器、コイル 11.1.4 電子デバイス
 - 11.1.5 ハイブリッドIC 11.1.6 水晶デバイス
 - 11.1.7 電気・電子部品向けのエポキシ配合樹脂の用途別需要量
 - 11.1.8 電子部品用エポキシ樹脂メーカーと製品

II 製品市場編

- 1 電気・電子部品用途
 - 1.1 電気・電子部品用封止材料
 - 1.1.1 樹脂封止材料 1.1.2 セラミック封止材料
 - 1.1.3 封止材料参入企業と製品 1.1.4 電気部品用パッケージの名称と機能
 - 1.1.5 半導体・電子部品封止材料
 - 1.2 半導体封止用エポキシ材料
 - 1.2.1 モールドイングコンパウンドと成形方法
 - 1.2.2 モールドイングコンパウンドメーカーの生産能力
 - 1.2.3 モールドイングコンパウンドの市場規模 1.2.4 半導体市場
 - 1.2.5 半導体封止材メーカーの概要と製品
 - 1.3 半導体封止用の充填材料
 - 1.3.1 半導体用エポキシ封止材料の配合例
 - 1.3.2 封止材用充填材料 1.3.3 シリカ材料の表面処理(シランカップリング剤)
 - 1.4 液状エポキシ樹脂封止材
 - 1.4.1 液状エポキシ封止材の概要 1.4.2 市場規模
 - 1.4.3 液状エポキシ封止材メーカーと製品
 - 1.5 電子回路基板
 - 1.5.1 電子回路基板の分類 1.5.2 電子回路基板の種類 1.5.3 組成による分類
 - 1.5.4 電子回路用途別材料 1.5.5 電子回路基板の生産推移
 - 1.5.6 電子回路基板メーカー65社の概要
 - 1.6 LED
 - 1.6.1 LEDの市場動向 1.6.2 LED封止材の市場規模

- 2 その他製品
 - 2.1 繊維強化材料 2.2 エポキシ樹脂系接着剤 2.3 エポキシ樹脂塗料

III 中国のエポキシ樹脂市場編

- 1 中国のエポキシ樹脂生産能力
 - 1.1 中国のエポキシ樹脂メーカーと生産能力
 - 1.2 日系フォーミュレーター 1.3 その他のメーカー
- 2 エポキシ樹脂需給バランスシート
- 3 エポキシ樹脂需要動向
 - 3.1 エポキシ樹脂需要量(中国) 3.2 エポキシ樹脂輸出入動向
 - 3.3 中国及び香港の輸入、輸出統計
- 4 主要需要先

IV 世界のエポキシ樹脂市場編

- 1 エポキシ樹脂の世界需要
 - 1.1 世界における需要金額 1.2 世界における需要用途

書籍申込用紙

書籍名：Z097(2015エポキシ樹脂・応用製品市場の実態と展望)

購入冊数

冊

DM

| | | | |
|--|---------------------------------|-------|--|
| 会社名 団体名 | | | |
| 部署・役職 | | | |
| ふりがな | | | |
| 氏名 | 住所 | 〒 | |
| TEL | FAX | | |
| E-mail | ※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。 | | |
| STbook会員(無料)に <input type="checkbox"/> 登録する <input type="checkbox"/> 登録済み | | 振込予定日 | |
| | | 月 日 | |
| 今後、弊社からのご案内が不要な方は以下に✓印をつけてください。 <input type="checkbox"/> 郵送DM不要 <input type="checkbox"/> E-mail不要 | | 通信欄 | |

※左記ご記入の上、**FAX 03-3261-0238**までお申込みください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

■お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。または当社ホームページからお申し込みください。

■商品の発送

お申込み日の翌営業日までに書籍、請求書、納品書を佐川急便で発送いたします。
※未刊書籍は発刊次第お送りいたします。

■お支払

銀行振込・ゆうちょ銀行払込(郵便振替)にてお願いいたします。クレジットカード払いは受け付けておりません。書籍・請求書到着後、1か月以内にお振込みください。銀行振込・ゆうちょ銀行払込(郵便振替)の手数料は、ご負担ください。原則として領収書は発行いたしません。ゆうちょ銀行払込取扱票(郵便振替票)は、書籍に同封しております。

■個人情報の取り扱い

ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、ご案内等に使用いたします。